

深圳市江波龙电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-011

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☒电话会议 ☐媒体采访 ☐路演活动 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	永赢基金
时间	2026 年 9 月 28 日(周一) 10:00-11:00
地点	深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号鸿荣源前海金融中心二期 B 座 2301
上市公司接待人员姓名	投资者关系经理 黄琦 投资者关系资深主管 苏阳春

投资者关系活动 主要内容介绍	1、公司与高通合作的端侧 AI 存储的进展如何？公司技术在其中发挥了怎样的作用？如何看待公司端侧 AI 存储方案未来的市场应用前景？ 答：近期，高通宣布与江波龙等合作伙伴开展多方合作，基于第六代骁龙®8 超级至尊版移动平台，将阶跃 StepEdge-Omni 30B-MoE（混合专家）模型面向端侧进行深度适配与推理优化，成功打造具备自主服务和个性化能力的端侧智能体助手。公司端侧 AI 存储解决方案，围绕 AI 数据的访问特点与计算时序设计，通过存储参与端侧 AI 推理数据调度，可实现模型权重从端侧 NAND Flash 存储的高效加载。该技术通过存储与计算协同能够减少大模型对 DRAM 的持续占用，显著提升模型加载和运行效率。 除本次与高通的合作外，公司已与 AMD、紫光展锐等多家全球主要的主芯片厂开展端侧 AI 存储方案的适配工作。其中，基于和 AMD 的联合调优，在 AI 移动工作站及 AI PC 平台的测试数据显示，搭载公司智能软硬件架构的设备，AI PC 端模型规模提高约 3.2 倍，内存利用效率提升约 200%，这一技术将为 AI PC 在普通个人用户的大规模推广奠定重要的存储技术底座。 目前，“内存墙”的物理限制与高昂的内存成本，已成为大模型在端侧 AI 广泛应用的重要阻碍。公司端侧 AI 存储方案，在保证客户体验基本不变的前提下，能够实现 NAND Flash 与 DRAM 整体存储方案在成本和技术优化层面的最优解，具备极为广阔的市场应用前景。公司正与重要合作伙伴一道，推进相关技术的产品化和市场推广。 2、如何看待公司未来的盈利变化趋势？ 答：从存储器行业的历史经营情况看，企业的长期盈利能力既取决于技术实力、产业链协同能力等综合竞争优势，也与高端客户占比密切相关。通常而言，行业领先企业具备
---------------------------	--

	技术能力、产品矩阵及产业链布局等多方面优势，能够更好地满足大客户对产品性能、兼容适配、可靠性及稳定供货等方面的综合要求，高端客户占比较高，并具有更强的盈利能力和相对明显的弱周期特征。 在 AI 发展浪潮下，公司全面拥抱端侧 AI，前期重点投入的主控芯片、企业级存储、mSSD 等产品已陆续取得实质性商业进展，并持续深化与全球知名客户的合作和导入，不断提升高端客户收入占比，为公司业务增长及盈利能力提升提供支撑。近期，公司还推出了 HLC(高级缓存技术)、AIDIMM、AILPBGA 等端侧 AI 存储的新技术、新产品。随着相关产品逐步导入市场并实现更广泛的规模化应用，公司高端、高壁垒、高附加值产品的收入占比有望进一步提升，持续优化产品结构和盈利结构。 3、mSSD 产品的导入情况如何？ 答：公司 mSSD（Micro SSD）产品通过 SiP（System in Package）封装技术，将主控芯片、存储芯片（Die）、无源元件（电阻、电容等）等不同功能的集成电路集成在一个封装体内，实现 20×30×2.0 mm 的产品体积，尺寸远小于传统 PCBA SSD。mSSD 产品性能满足 PCIe 的高标准，并通过简化传统 PCBA SSD 的复杂生产流程，具备明显的综合成本优势。 mSSD 高度契合了 AI PC 对极致性能与紧凑形态的苛刻要求，公司正着力推动 mSSD 成为新一代产品标准，目前已在多家全球头部 PC 厂商实现规模化商业应用。 4、如何看待存储价格未来变化趋势？ 答：结合第三方机构公布的信息来看，AI 在云端和端侧落地，是较为明确的产业趋势，并将带来巨大的存储需求增量；受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的 NAND 资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的 NAND 供
--	--

	给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无